



知財統計情報

台湾公開公報統計(2025年発行分)

IPC	技術内容	件数
H01L	クラスH10に包含されない半導体装置（測定のための半導体装置の使用G01；抵抗器一般H01C；磁石，インダクタまたは変成器H01F；コンデンサー一般H01G；電解装置H01G9/00；電池または蓄電池H01M；導波管，導波管型の共振器または線路H01P；電線接続器または集電装置H01R；誘導放出装置H01S；電気機械的共振器H03H；スピーカ，マイクロホン，蓄音機ピックアップまたは類似の音響電気機械変換器H04R；電気的光源一般H05B；印刷回路，ハイブリッド回路，電気装置の箱体または構造的細部，電気部品の組立体の製造H05K；特別な応用をする回路への半導体装置の使用は，当該応用サブクラス参照）	8800
G06F	電氣的デジタルデータ処理（特定の計算モデルに基づくコンピュータ・システムG06N）	4559
A61K	医療用製剤，歯科用製剤又は化粧品製剤（薬物を特定の物理的または投与形態に変化させるのに特に適合した装置または方法A61J3/00；空気の脱臭用品，殺菌または消毒用品，あるいは包帯，被覆用品，吸収性パッド，または手術用品のための物質の使用又は化学的事項A61L；石鹼の組成C11D）	3734
A61P	化合物または医薬製剤の特殊な治療活性 [7]	3337
G02B	光学要素，光学系，または光学装置 [7]	2396
H05K	印刷回路；電気装置の箱体または構造的細部，電気部品の組立体の製造	2169
H10D	無機電氣的半導体装置 [2025.01]	1834
G03F	フォトメカニカル法による凹凸化又はパターン化された表面の製造，例．印刷用，半導体装置の製造法用；そのための材料；そのための原稿；そのために特に適合した装置（写真植字機B41B；写真用感光材料または処理G03C；エレクトログラフィー，そのための感光層または処理G03G）	1830
G06Q	管理目的，商用目的，金融目的，経営目的または監督目的に特に適合した情報通信技術 [ICT]；他に分類されない，管理目的，商用目的，金融目的，経営目的または監督目的に特に適合したシステムまたは方法 [2006.01]	1789
B32B	積層体，すなわち平らなまたは平らでない形状，例．細胞状またはハニカム状，の層から組立てられた製品	1510



知財統計情報

IPC	技術内容	件数
C08L	高分子化合物の組成物（重合性単量体に基づく組成物C08F, C08G; 人造フィラメントまたは人造繊維D01F; 繊維処理用組成物D06） [2]	1466
C23C	金属質への被覆; 金属材料による材料への被覆; 表面への拡散, 化学的変換または置換による, 金属材料の表面処理; 真空蒸着, スパッタリング, イオン注入法または化学蒸着による被覆一般 (金属被覆製品の押し出しによる製造B21C23/22; 既存の層を物品に結合することによる金属被覆は, 当該の箇所を参照, 例. B21D39/00, B23K; ガラスのメタライジングC03C; モルタル, コンクリート, 人造石, セラミックスまたは天然石のメタライジングC04B41/00; 金属へのほうろう被覆, または金属へのガラス質層の形成C23D; 電気分解もしくは電気泳動による金属表面の処理または金属への被覆C25D; 単結晶膜の成長C30B; 繊維製品の金属処理によるD06M11/83; 部分的な金属処理による繊維製品の装飾D06Q1/04) [4]	1346
C08G	炭素-炭素不飽和結合のみが関与する反応以外の反応によって得られる高分子化合物 (発酵または酵素を使用して所望の化学物質もしくは組成物を合成する方法またはラセミ混合物から光学異性体を分離する方法C12P) [2]	1209
G01N	材料の化学的または物理的性質の決定による材料の調査または分析 (参照, 免疫分析以外の酵素または微生物を含む測定または試験の装置または方法C12M, C12Q)	1173
C08K	無機または非高分子有機物質の添加剤としての使用 (ペイント, インキ, ワニス, 染料, 艶出剤, 接着剤C09) [2]	1119
C07D	複素環式化合物 (高分子化合物C08) [2]	1115
C07K	ペプチド (β -ラクタム環含有ペプチドC07D; 環状ジペプチドであって, その分子中にその環を形成するペプチド結合以外のペプチド結合を有しないもの, 例. ピペラジン-2, 5-ジオンC07D; 環状ペプチド型の麦角アルカロイドC07D519/02; 単細胞蛋白質, 酵素C12N; ペプチドを得るための遺伝子工学的的方法C12N15/00) [4]	1050
G02F	本サブクラスに包含される素子の媒体の光学的性質の変化により光を制御するための光学装置または光学的配置; 光の周波数変更; 光学的理論素子; 光学的アナログ/デジタル変換器 [4]	1024
C08J	仕上げ; 一般的混合方法; サブクラスC08B, C08C, C08F, C08GまたはC08Hに包含されない後処理 (プラスチックの加工, 例. 成形B29) [2]	1011



知財統計情報

IPC	技術内容	件数
C08F	炭素-炭素不飽和結合のみが関与する反応によってえられる高分子化合物（炭素数がより少ない炭化水素からの液体炭化水素混合物の製造，例．オリゴメリゼーションによる，C 1 0 G 5 0 / 0 0；発酵または酵素を使用して所望の化学物質もしくは組成物を合成する方法またはラセミ混合物から光学異性体を分離する方法C 1 2 P；繊維，より糸，糸，織物，またはこのような材料から製造された繊維製品への単量体のグラフト重合D 0 6 M 1 4 / 0 0） [2]	990
H01J	電子管または放電ランプ（スパークギャップH 0 1 T；消耗する電極を有するアークランプH 0 5 B；粒子加速器H 0 5 H）	990
C09K	他に分類されない応用される物質；他に分類されない物質の応用	984
H10B	電子記憶装置 [2 0 2 3. 0 1]	971
H04N	画像通信，例．テレビジョン [4]	947
C12N	微生物または酵素；その組成物；微生物の増殖，保存，維持；突然変異または遺伝子工学；培地（微生物学的試験用の培地C 1 2 Q 1 / 0 0） [3]	919
G11C	静的記憶（半導体記憶装置H 1 0 B）	919
G01R	電気的変量の測定；磁気的変量の測定（共振回路の正しい同調の指示H 0 3 J 3 / 1 2）	918
H04L	デジタル情報の伝送，例．電信通信（電信通信と電話通信に共通の装置H 0 4 M） [4]	878
H04W	無線通信ネットワーク（放送通信H 0 4 H；選択式通信によらない無線接続を用いる通信システム，例．ワイヤレスエクステンションH 0 4 M 1 / 7 2） [2 0 0 9. 0 1]	844
G06T	イメージデータ処理または発生一般 [2 0 0 6. 0 1]	822



知財統計情報

出願人	件数
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY, LTD.	1416
APPLIED MATERIALS, INC.	970
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	780
TOKYO ELECTRON LIMITED	674
COUPANG CORP.	671
QUALCOMM INCORPORATED	617
NANYA TECHNOLOGY CORPORATION	454
NITTO DENKO CORPORATION	398
AUO CORPORATION	394
ASML NETHERLANDS B.V.	350
ACER INCORPORATED	349
INVENTEC CORPORATION	346
INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE	311
INNOLUX CORPORATION	292
LAM RESEARCH CORPORATION	286
SCREEN HOLDINGS CO., LTD.	275
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.	274
RESONAC CORPORATION	236
MEDIATEK INC.	220
FUJIFILM CORPORATION	219
PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.	212
KIOXIA CORPORATION	210
UNITED MICROELECTRONICS CORP.	199
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	194
SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.	192
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED	178
WONDERLAND SWITZERLAND AG	178
NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION	169
ASM IP HOLDING B.V.	163
DELTA ELECTRONICS, INC.	157